

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、本协议为意向性、框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

#### 一、协议的基本情况

##### 1、协议签订的基本情况

2019年6月26日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与光谷光电子信息产业园建设管理办公室（以下简称“甲方”）签署了《高端测试设备研发及智能制造产业园项目框架协议书》（以下简称“本协议”）。公司计划总投资约30亿元在武汉东湖新技术开发区投资建设高端测试设备研发及智能制造产业园。

##### 2、协议对方的基本情况

光谷光电子信息产业园建设管理办公室

武汉东湖新技术开发区成立于1988年，1991年被国务院批准为首批国家级高新区，2001年被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地，即“武汉中国光谷”，2007年被国家发改委批准为国家生物产业基地，2009年被国务院批

准为全国第二个国家自主创新示范区，2011 年被中组部、国务院国资委确定为全国四家“中央企业集中建设人才基地”之一。2016 年获批国家首批双创示范基地，并获批为中国（湖北）自贸试验区武汉片区。

光谷光电子信息产业园建设管理办公室是东湖高新区八大园区之一，是其中企业数量最多、经济总量最大的园区，面积 82.38 平方公里

光谷光电子信息产业园建设管理办公室和公司不存在关联关系。

### 3、签订协议尚需履行的决策程序

本协议为意向性、框架性协议，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序。

## 二、协议的主要内容

### （一）签约主体

甲方：光谷光电子信息产业园建设管理办公室

乙方：武汉精测电子集团股份有限公司

### （二）项目内容

乙方计划总投资约 30 亿元，建设高端测试设备研发及智能制造产业园，包括一个研发基地和显示测试设备、半导体测试设备、新能源测试设备三大产业园，并计划通过一系列半导体、面板显示、新能源产业的海外并购，促进国内相关领域的测试专用设备行业的发展，加快核心技术的国产化。

### （三）合作事项

1、甲方全力支持乙方发展，协助乙方办理相关项目手续，申请国家和省、市、东湖高新区各种支持政策，最终以实际审批结果为准。

2、乙方确保项目实施内容符合国家和省、市、东湖高新区各项法律法规并获得相关批准。

### （四）其它事项

1、其它未尽事宜双方另行商议签署相关协议约定。

2、双方同意对本协议的存在及其内容保密。此外，未经信息提供方许可，双方之间通过任何形式交流的任何保密信息不得向双方以外的其他个人或单位披露，但向为履行其职责而确有必要知悉保密信息的双方雇员或其关联机构、双方所聘请的律师、会计师或其他顾问机构的雇员披露以及依据可适用的法律法规或深圳证券交易所的要求需要披露的、已经通过合法途径进入公共领域、按有管

辖权的公安或司法部门的命令而提供的信息除外。

3、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

### 三、对公司的影响

此次与甲方的合作，将发挥各自优势，更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源测试设备领域的持续快速增长的发展趋势，满足区域下游新兴产业快速发展的需求。因此本次协议签署有利于巩固和提升公司综合竞争实力，提高产能和贴近市场，符合公司未来发展策略和全体股东的利益，对公司布局市场和产能具有重要战略意义。本协议为意向性、框架性协议，对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

### 四、重大风险提示

1、本协议为意向性、框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

3、公司近三年未披露过战略框架（合作）协议。

4、未来三个月内，公司除持股 5%以上股东陈凯所持有的股份存在减持的风险外，其余持有公司 5%以上股东以及公司的控股股东所持限售股份不存在即将解除限售或减持的风险。

### 五、其他应披露的事项及后续进展情况的披露

本协议签署后，公司与甲方将积极推动相关工作，并将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，由于本次投资事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

1、《高端测试设备研发及智能制造产业园项目框架协议书》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年6月26日